

<<现代电子产品组装工艺>>

图书基本信息

书名：<<现代电子产品组装工艺>>

13位ISBN编号：9787040336993

10位ISBN编号：7040336995

出版时间：2012-1

出版时间：高等教育出版社

作者：朱宏，等 编

页数：290

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<现代电子产品组装工艺>>

内容概要

《教育部和财政部中等职业学校教师素质提高计划成果：现代电子产品组装工艺》是教育部和财政部“中等职业学校教师素质提高计划”中“电子技术应用专业师资培训包开发项目（LBZD036）”的成果之一。

《教育部和财政部中等职业学校教师素质提高计划成果：现代电子产品组装工艺》分为7个相对独立的单元：电子企业模拟参观，电子企业安全用电、静电防护与5S，电子元器件识别与进货检验，通孔PCB组件组装，表面贴装印制电路板的手工组装与返修，手工组装SD-202T型收音机，表面贴装印制电路板组装。

这7个实训单元是中等职业技术学校《电子技术应用专业教师教学能力标准（试行）》中要求的重要内容，也是现代电子产品生产、组装的核心知识和技能。

培训项目紧密结合现代电子制造企业的PCB组装、SMT、测试、物料采购与准备、品质检验与管理等岗位的工作任务。

项目按照由简单到复杂，从相对单到综合应用的逻辑关系组织和递进。

书中安排了技能训练和综合应用两个层面的项目。

技能训练项目参照国际通行的行业标准PC-610C设计，以奠定完成综合项目必需的技能。

综合项目以完成有实用价值的典型电子产品（通孔、表面混装的收音机、计算机主板）为目标成果，按照理论实践体、行动导向和工作过程引领的教学理念编写，以培训学员的综合职业能力。

技能训练项目和综合项目既符合职业成长规律，又便于国家职教基地用于上岗、提高、骨干三个层级的教师培训时灵活选用。

本书的编写是为满足中等职业学校电子技术应用专业教师国家级培训的急需，也试图为电子类专业工艺课程教学及实训提供可供参考的解决方案。

本书可作为中等职业学校电子类专业的教材和电子企业的员工培训教材。

<<现代电子产品组装工艺>>

书籍目录

单元一 电子企业模拟参观【学习目标】【任务描述】【模拟企业参观】1.1 参观前准备1.2 PCB、PCBA与元器件1.3 计算机主板生产流程1.4 SMT生产线1.5 插件生产线【参观汇报】【单元教学策略】单元二 电子企业安全用电、静电防护与5s【学习目标】【任务描述】【培训内容】2.1 安全生产【参观学习】2.2 静电防护【参观学习】【技能训练】2.3 5S管理【5s训练】单元三 电子元器件识别与进货检验【学习目标】【任务描述】【相关知识】3.1 电阻器3.2 电容器3.3 电感器3.4 二极管3.5 三极管3.6 集成电路【技能训练】3.7 电子元器件的识别与简易测试【单元教学策略】单元四 通孔PCB组件组装【学习目标】【任务描述】【任务分析】4.1 手工焊接【任务描述】【学习目标】【相关知识】【焊点质量标准】【元器件定位与安装质量标准】【技能训练】4.2 手工组装OTL功放电路.....单元五 表面贴装印制电路板的物工组装与返修单元六 手工组装SD - 202T型收音机单元七 表面贴印制电路板组装附录

<<现代电子产品组装工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>